



PFTA  
Polymeric foam Technology Alliance  
高分子發泡材料技術聯盟

# 2018 Taipei Foam Summit

May 18, 2018 Taipei, Taiwan

*Trends &  
New Development*

# 2018 Taipei Foam Summit

高分子發泡材料一直是高分子材料中的重要領域，根據其結構型態，有不同的用途，開孔泡材料適用於過濾、催化、緩衝、吸音等，而閉孔泡材料則適用於結構應用和熱絕緣上。發泡材料不僅在隔音、減重、絕熱，在生醫、光電、能源、航太材料上也有許多應用，每年塑膠的消耗量大約有 10% 是用於製造各種不同的泡材。根據市場調查機構 Markets and Markets 報告指出，到 2021 年，高分子發泡材料的市場規模估計將達到 1720 億美元，複合增長率為 8.5%，而熱塑性高分子發泡是其中成長最迅速的一環。

本次由科技部高分子發泡材料技術聯盟主辦之研討會特別邀請世界性的發泡技術權威 Foam Update 李紹唐博士以及高分子發泡領域裡面最著名的加拿大多倫多大學 Chul B. Park 教授，針對高分子發泡技術發展趨勢、發泡基礎理論、押出發泡技術、發泡射出成型技術、泡珠技術、奈米成纖技術於發泡的應用及產業化等議題，以及進行交流討論。期待大家共襄盛舉，更希望藉由本次活動，加深參與者對發泡材料技術與市場應用的了解，以利業者投入高值化發泡材料研發。本次會議更特別提供全中文化講義。鼓勵產業界共襄盛舉。

## 議程

| Time          | Speaker                     | Topic  |
|---------------|-----------------------------|--|
| 08:30 – 09:00 | Registration                |  |
| 09:00 – 09:30 | Prof. Shu-Kai Yeh<br>葉樹開副教授 | Opening Remark<br>開場介紹、高分子發泡產學小聯盟簡介  |
| 09:30 – 10:45 | Dr. S.T. Lee<br>李紹唐博士       | Trends and Challenge for Polymeric Foam<br>高分子發泡材料技術未來趨勢及挑戰 (一)  |
| 10:45 – 11:15 | Tea Break                   |  |
| 11:15 – 12:30 | Dr. S.T. Lee<br>李紹唐博士       | Trends and Challenge for Polymeric Foam<br>高分子發泡材料技術未來趨勢及挑戰 (二)  |
| 12:30 – 13:40 | Lunch                       |  |
| 13:40 – 14:55 | Dr. Chul B. Park            | Fundamentals and Foaming Technologies<br>Extrusion Foaming Technology<br>發泡技術基礎理論、押出發泡   |
| 14:55 – 15:25 | Tea Break                   |  |
| 15:25 – 16:40 | Dr. Chul B. Park            | Foam Injection Molding Technology<br>Bead/Particle Foaming<br>Innovative Nano-Fibril Technology for Improving<br>Foaming Ability and Mechanical Properties<br>射出發泡、泡珠技術、奈米成纖技術於發泡的應用 |
| 16:40 – 17:00 | Discussion & Summary        |  |

## 講師介紹



### 講師 Dr. S. T. Lee 李紹唐博士

李紹唐博士，出生於台北，1980 年畢業於清華大學，後赴美留學，在史蒂芬理工學院師從著名學者 Biesenberger，並於 1986 年獲得博士學位，一直專注於高分子加工及聚合物發泡方面的研究及產品開發，曾任美國 Sealed Air 公司 Senior Research Fellow。並於 2001 年當選國際塑膠工程師學會(SPE)會士，2018 年 SPE 熱塑性與發泡材料分項傑出成就獎。

李紹唐博士先後發表了 30 多篇期刊/會議文章，及 23 項美加地區專利，作為主編先後出版了五本專著，包括：

《Foam Extrusion: Principles and Practice》，

《Polymeric Foams: Mechanism and Materials》，

《Thermoplastic foam Processing: Principles and Development》，

《Polymeric Foams: Science and Technology》和

《Polymeric Foams: Technology and Developments in Regulation, Process, and Products》。

李博士目前同時為 SCI 期刊 Journal of Cellular Plastics 共同主編，並為 Foamupdate Newsletter 及 Polyfoam 會議創辦人，每年固定於中國大陸以及歐洲舉辦 Polyfoam 國際研討會。



### 講師 Dr. Chul B. Park

Chul B. Park 教授是加拿大微發泡塑膠首席科學家，多倫多大學傑出講座教授，加拿大皇家科學院、加拿大工程院、韓國科學技術翰林院、韓國工程翰林院四院院士，也是國際塑膠工程師協會(SPE)會士、美國機械工程師協會(ASME)等重要學會會士、在超臨界二氧化碳聚合物發泡機制及應用研究方面成果領先全球，在中國更有發泡帝的稱號。

Professor Park 目前已累計發表 300 餘篇 SCI 研究論文，400 多篇會議論文，超過 1300 次以上的國際會議發表，獲准授權專利 20 餘項，目前並擔任重要發泡專業期刊 Journal of Cellular Plastics 主編，Park 教授長期教授 SPE Foams Conference 基礎教育講座，並與李紹唐博士合作參編著了四本專著，另外還編著了《Polylactide Foams: Fundamentals, Manufacturing, and Applications》及《Biofoams: Science and Applications of Bio-Based Cellular and Porous Materials》。

Professor Park 近年來除了在基礎理論上迭有新發現外，在發泡產業化部分更有許多新成就，奈米成纖技術目前已預計投產，目前仍有數個產業化技術發展中。

- 活動日期：2018 年 5 月 18 日（五）08:30 – 17:00
- 活動地點：國立臺灣科技大學 國際大樓三樓 IB-302 會議廳（台北市大安區基隆路四段 43 號）
- 活動費用：NTD 7700/人，5 月 10 日前報名享早鳥價 7000/人優惠，同一單位三人以上同行享 NTD 5500/人優惠，同時加入高分子發泡材料技術聯盟會員另享優惠，大專院校全職學生憑證報名享 NTD 3300/人優惠，5/10 前報名享 NTD3000/人優惠。
- 注意事項：
  - ①名額有限，請提早報名，額滿為止。
  - ②報名截止日：5 月 14 日
  - ③欲取消參加活動者，請於報名截止日前提出以利作業，截止日後提出者恕不退費，退費作業將統一於活動結束後進行。
  - ④開立收據皆以報名表上填寫為主。
  - ⑤若遇不可抗力之因素，主辦單位保留活動日期、講師、內容更換之權利。
- 聯絡窗口：若對本會議有疑問請洽詢 02-27333141 分機 7412 黃小姐，  
E-mail：[chihyi.h@gapps.ntust.edu.tw](mailto:chihyi.h@gapps.ntust.edu.tw)

-----◆報名表回傳◆-----

(報名表填寫後請拍照或寄至上方信箱，標題：2018 Taipei Foam Summit 報名，並來電確認。)

| 2018 Taipei Foam Summit ( 2018/05/18 ) |  |       |             |                            |        |
|--|--|-------|-------------|----------------------------|--------|
| 公 司 全 名                                | <input type="checkbox"/> 有限公司<br><input type="checkbox"/> 股份有限公司   |       |             | 公司統編                       |        |
| 聯 絡 地 址                                | □□□  |       |             | 傳真號碼                       |        |
| 公司 e-Mail                              |  |       |             | 聯絡電話                       | 分機     |
| 參加者姓名                                  | 身分證字號  | 部門/職稱 | 翻譯設備<br>是/否 | 用餐<br>葷/素                  | e-Mail |
|  |  |       |             |                            |        |
|  |  |       |             |                            |        |
|  |  |       |             |                            |        |
| 聯 絡 電 話                                | 分機   |       | 手機號碼        |                            |        |
|  | 分機   |       |             |                            |        |
|  | 分機   |       |             |                            |        |
| 繳費方式                                   | ※ 請先行繳費以完成報名手續<br>※ 請於劃撥/匯款單 <b>通訊欄</b> 上註明研討會報名費、姓名<br>若需請款請加註公司抬頭統編。<br>郵政劃撥<br>戶名：國立臺灣科技大學收款專戶<br>帳號：50039472 |       |             | 劃 撥 / 匯 款<br><br>收 據 黏 貼 處 |        |

備註:由於講者內容訊息量大，現場主要提供中英文對照講義為主，同步翻譯為輔。